

# Okamoto

## SEMICON<sup>®</sup> セミコンジャパン2014出展のご案内 Japan2014

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、有り難く厚くお礼申し上げます。

東京ビッグサイトにてセミコンジャパン2014が開催されます。

弊社はTSV、グリーンデバイス、MEMS及びパッケージ向けの加工技術と薄厚化装置をご紹介します。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが、弊社小間にご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

平成26年11月吉日

株式会社岡本工作機械製作所

代表取締役社長 石井 常路

### 出展内容

- **TSV** ..... Cuコンタミネーション対策新プロセスと最新装置
- **グリーンデバイス** ..... SiC,GaN 低ダメージ、高速加工技術と装置
- **パッケージ** ..... 樹脂及び金属の同時研削加工技術
- **MEMS** ..... 高精度、チップングレス加工技術
- **450mmウェーハ加工** ..... 450mm対応装置
- **大型材料** ..... ガラス、セラミック等の大型材料加工装置

# Okamoto

**SEMICON**<sup>®</sup> SEMICON JAPAN 2014 Information  
*Japan 2014*

To all our valued customers.

Hope you are doing well.

We are participating Semicon Japan 2014 at Tokyo Big Sight , Tokyo.

We are introducing the following at this show:

1. TSV process and machine
2. Green devices
3. MEMS and packages processing

Everyone at Okamoto is looking forward to your visit.

BEST REGARDS

Okamoto Machine Tool Works, Ltd.

Chairman *Tsuneyuki Ishii*

## Exhibits

- **TSV Process** ..... Cu contamination prevention, new process and latest machine.
- **Green devices process** ..... Low damage and high speed process and machine
- **Packages** ..... Simultaneous grinding and polishing of resin and metal material
- **MEMS** ..... High accuracy and chipping less process
- **450mm wafer** ..... Equipment and process for 450mm wafers
- **Large size** ..... Glass, ceramics and special material processing technology for extra large work pieces